

比表面積及孔隙分佈分析儀使用辦法暨申請表

一、 樣品準備及說明

樣品前處理:經過事先高溫處理過之樣品(處理溫度>500°C),需先在100°C烘箱內烘1天去除吸附之水氣。未經過高溫處理之樣品(樣品內或結構上含有界面活性劑、改質劑、或其他有機物者),請附上TGA熱分析圖,避免在樣品前處理之除氣階段造成有機物裂解、揮發導致系統污染。

二、 自行操作機台訓練及檢定

1. 訓練方式由負責技士訓練或實驗室傳承訓練。
2. 上機考試:由負責技士檢定使用操作情形,通過者即具有使用執照。

三、 相關使用規定

1. 預約使用必須為本人到場,若有責任歸屬是以該時段預約者之責任。
2. 操作機台時必須詳實填寫使用紀錄表,若機台發生異狀須詳實填寫狀況、初步應變措施並通知技士處理。
3. 使用者必須遵守操作規範,非關正常操作機台的一切行為一概禁止,如有不當使用造成損壞,需負修理賠償責任。

申請者簽名: _____ 申請日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

聯絡電話及電子信箱: _____ 指導教授簽名: _____

使用方式: 自行操作(限環工所,每4小時150元,不足4小時以4小時計費)

自行操作須提供實驗場所安全衛生教育證書

A 證書號碼: _____ ; B 證書號碼: _____

申請期間:至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

委託操作

比表面積分析 (環工所委託操作 1,000 元/件,外系委託操作 1,200 元/件)

中孔分析 (環工所委託操作 2,000 元/件,外系委託操作 2,400 元/件)

微孔分析 (環工所委託操作 3,000 元/件,外系委託操作 3,600 元/件)

委測樣品敘述:(表格不足處,請再自行增加)

樣品件數	樣品 1	樣品 2	樣品 3	樣品 4	樣品 5
樣品說明 (成分、製造程序)					
熔點 (或熱裂解溫度)					
預估比表面積					
除氣溫度					
除氣時間					